

平成 24 年 12 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー
代 表 者 名 代表取締役社長 名屋佑一郎
(JASDAQコード番号6787)
問 い 合 わ せ 先 執行役員 経営管理室長 古屋督生
T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

独シュバイツァー エレクトロニック社との 合弁会社の設立に関する契約書締結のお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 17 日開催の取締役会において、ドイツ連邦共和国の大手電子回路基板製造販売会社であるシュバイツァー エレクトロニック社（正式名称：Schweizer Electronic Aktiengesellschaft）（以下 SEAG 社といいます）との間で、電子回路基板の製造用設備のリースを主要な事業とする合弁会社の設立について決議し、合弁会社設立契約書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合弁会社設立の理由

当社は、これまで欧州市場における電子回路基板の販路拡大のため、ドイツの電子回路基板製造会社である SEAG 社との間で、平成 21 年 4 月 24 日付で業務提携に関する基本合意、平成 21 年 7 月 17 日付で欧州における販売委託契約、さらに平成 22 年 9 月 22 日付で将来の技術協力を視野に入れた資本提携契約を締結し、欧州市場での販売展開を進めて参りました。

今回の合弁会社設立の主旨は、欧州の自動車市場に対する販路を更に拡大することを目的に、両社共同の製造ラインを構築することであり、そのために必要となる製造設備を、本リース会社を通じて当社の生産拠点に導入いたします。当社がこれまで日系自動車市場を中心に構築してきた技術に、SEAG 社が有する欧州の自動車市場に向けた技術を融合することで、グローバルに自動車市場向け製品を供給することができる体制を整備してまいります。

2. 合弁会社設立の内容等

(1) 合弁会社設立の内容

平成 25 年 1 月を目途に SEAG 社との合弁会社（商号は協議中であります）を設立し、当該合弁会社が当社連結子会社である Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.（以下、当社ベトナム工場といいます）内に両社共同の製造ラインを導入し、当社ベトナム工場に製造設備をリース貸与いたします。当該製造ラインにおける具体的な製造品目、稼働開始時期および製造規模等は現在協議中であります。

(2) 合併会社の概要

① 商 号	Meiko Schweizer Electronics Hong Kong Co., Ltd. (予定)
② 本 店 所 在 地	Unit 2107A, Tower II Metroplaza, 223 Fong Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong (予定)
③ 代表者の役職・氏名	President 名屋 佑一郎 (予定) Vice President Dr. Marc Schweizer (予定)
④ 事 業 内 容	電子回路基板の製造用設備のリース
⑤ 資 本 金 の 額	6,000,000 米ドル (予定)
⑥ 設 立 年 月 日	平成 25 年 1 月 (予定)
⑦ 事 業 年 度 の 末 日	12 月
⑧ 純 資 産	6,000,000 米ドル (予定)
⑨ 総 資 産	15,000,000 米ドル (予定)
⑩ 出 資 比 率	名幸電子香港有限公司 (当社 100%連結子会社) : 50.1% Schweizer Electronic Singapore Pte., Ltd. (SEAG 社 100%連結子会社) : 49.9%

その他、合併会社の内容につきましては、詳細を検討中であります。

3. SEAG 社の概要

(1) 商 号	Schweizer Electronic Aktiengesellschaft	
(2) 本 店 所 在 地	ドイツ連邦共和国 シュランベルク市 (Schramberg)	
(3) 代表者の役職・氏名	Dr. Marc Schweizer (CEO)	
(4) 事 業 内 容	電子回路基板および電子部品の製造販売	
(5) 資 本 金 の 額	9,664,054 ユーロ (約 10 億 3 千万円) 円換算は、平成 24 年 11 月 30 日のレートを使用しています	
(6) 設 立 年 月 日	1849 年 10 月	
(7) 大株主及び持株比率	Gerhard Schweizer 相続財団 15.25% Christoph Schweizer 15.07% (Gerhard Schweizer は現 COO である Bernd Schweizer の親族であり、Christoph Schweizer は現 CEO である Marc Schweizer の親族であります。)	
(8) 上場会社と当該会社との関係等	資 本 関 係	平成 22 年 9 月 21 日締結の株式売買契約および株式引受契約に基づき、資本提携をしております。
	取 引 関 係	平成 21 年 7 月 17 日締結の販売委託契約に基づき、当社子会社より電子回路基板を納品しております。

	人 的 関 係	当社より出向者が2名ございます。	
	関連当事者への 該 当 状 況	該当事項はございません。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位：千ユーロ) 円換算は、平成24年11月30日のレートを使用しています			
	平成21年12月期	平成22年12月期	平成23年12月期
純 資 産	15,670 (1,670 百万円)	36,958 (3,939 百万円)	41,980 (4,474 百万円)
総 資 産	50,770 (5,411 百万円)	73,199 (7,802 百万円)	71,154 (7,584 百万円)
1 株 当 た り 純 資 産 (ユーロ)	4.35 (463.65 円)	9.78 (1,042.14 円)	11.11 (1,183.76 円)
売 上 高	65,835 (7,017 百万円)	105,395 (11,233 百万円)	105,352 (11,229 百万円)
営 業 利 益	△4,030 (△429 百万円)	15,532 (1,655 百万円)	7,242 (771 百万円)
経 常 利 益	△4,030 (△429 百万円)	15,532 (1,655 百万円)	7,242 (771 百万円)
当 期 純 利 益	△4,466 (△476 百万円)	13,444 (1,432 百万円)	6,467 (689 百万円)
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (ユーロ)	△1.24 (△132.17 円)	3.56 (379.46 円)	1.71 (182.26 円)
1 株 当 た り 配 当 金 (ユーロ)	配当無し	0.42 (50.09 円)	0.47 (44.76 円)

※会計基準の差異のため、連結経常利益は連結営業利益と同額としております。

4. 日程

平成24年12月17日 合弁会社設立契約書 締結
平成25年1月(予定) 合弁会社設立

5. 今後の見通し

本件に伴う当期連結業績予想への影響は軽微であります。

以上